

成都华微电子科技股份有限公司

2025 年度“提质增效重回报”行动方案年度评估报告暨 2026 年度“提质增效重回报”行动方案

成都华微电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行“以投资者为本”核心理念，切实维护全体股东权益，基于对公司发展潜力的信心、企业价值的认同及社会责任担当，公司于 2025 年 4 月制定《2025 年度“提质增效重回报”行动方案》。通过全年系统化推进，公司在经营效率、市场竞争力、投资者权益保障及资本市场形象方面取得显著成效。为延续发展动能，公司于 2026 年启动新一轮规划，制定《2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。该方案全面总结 2025 年成果，并制定提升经营效率、强化市场竞争力、保障投资者权益、优化资本市场形象的具体措施。具体情况如下：

一、战略聚焦核心赛道，系统化构建竞争优势

2025 年，公司营业收入与利润均实现同比增长，并始终坚守“成为国家级集成电路科研、生产龙头企业和骨干力量，助力国家特种集成电路行业长远发展”的愿景。公司以技术赋能为核心竞争力，通过技术优势驱动产品竞争力升级，精准捕捉市场机遇；依托产品矩阵优化战略，持续完善多元化产品布局，满足客户个性化需求，市场认可度稳步提升；通过强化市场渗透与客户拓展策略，扩大客户群体规模。这一成果源于战略定力与团队协作的双重驱动，公司 2025 年全年共实现营业收入 75,998.73 万元，同比增长 25.85%；实现归属于上市公司股东净利润 15,360.55 万元，同比增长 25.73%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 11,947.24 万元，同比增长 36.36%。

1、持续推动创新，加强研发投入与成果转化

2025 年，公司研发支出占营收比重为 14.87%。主营业务领域新增申请发明专利 31 件、集成电路布图设计 22 件、软件著作权 11 件；获授权发明专利 14 件、集成电路布图 33 件、软件著作权 13 件。截至 2025 年末，公司累计持有发明专利 133 项、集成电路布图设计权 217 项、软件著作权 53 项、实用新型专利 9 项。

研发人员占比达 52.63%，净增加 112 人。

公司作为特种集成电路领域的深耕者，以研发为引擎，打造出高效协同的创新体系，从顶层设计到技术攻关均保持高强度投入，通过持续资源倾斜突破核心技术瓶颈。经过多年积累，公司已在 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC、TSN 网络交换板卡等核心领域形成自主知识产权集群，并承担和出色完成多项国家重点研发计划和科技重大专项任务。目前，公司整体技术储备稳居行业第一梯队，成为推动国内特种芯片突破的关键力量。

2025 年度内，公司最新研制的集成了公司自主设计的高速高精度 AD/DA 芯片和公司成熟可靠的 FPGA 芯片的相关产品，如 HWDSF700T 型射频直采 RFFPGA。在 MCU 方面，公司推出了自主研发的超低功耗 RISC-V MCU “HWD01001”，其运行频率高达 20MHz，支持硬件乘法和除法指令，内置 64KB eFlash，8KB SRAM 存储单元，广泛应用轻量化低功耗物联网终端设备、可穿戴设备、环境感知设备和工业监测设备等。在高速高精度 ADC 这一重点研发方向上，公司研制的 12 位 40GSPS 已向部分客户进行送样并已有意向订单。

公司将继续围绕高性能 FPGA、高速高精度 ADC、智能 SoC 等领域，持续加大对研发投入，着力打造“3+N+1”平台化产品体系。公司重点投入的研发项目进展与预计取得的成果如下：

序号	项目名称	2025 年投入金额（万元）	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
1	高性能 FPGA	4,805.78	已形成五百万门到亿门级 FPGA 谱系化产品；已形成集成高速 ADC/DAC 的 RF-FPGA 产品；已形成集成 CPU 和 FPGA 的异构 PSoC 产品；在研 2.5 亿和 4 亿门级 FPGA 产品；在研高端 FPGA 软件开发工具	集成高速 ADC/DAC、CPU 和信号处理定制加速单元，实现大带宽信号处理高性能处理平台	国内领先	数据处理、5G 通信、卫星通信、人工智能加速等大带宽信号处理计算平台等领域

序号	项目名称	2025年投入金额(万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
2	超高速ADC/DAC	1,886.94	已完成最高采样速率可达128GSPS超高速ADC/DAC样品研制	基于国内先进工艺制程,突破超高速ADC/DAC高采样速率、大带宽、低误码率的性能指标,形成8-16位10-160GSPS超高速ADC/DAC产品	国际先进	通信、雷达探测与对抗等领域
3	零中频射频收发机系列化产品研制	567.88	已完成HWD9361样品测试。完成了HWD9009晶圆流片	面向通信感知、无人机等需求广阔的市场化应用,研究国际现有先进产品替代解决方案,实现零中频射频收发机谱系化产品	国内领先	无人机、通信收发机等领域
4	智能异构系统(SoC)芯片	2,411.96	已成功研制用于边缘计算领域的人工智能芯片,AI算力高达16Tops,已在特种行业的多个客户里小批量试用。更高性能和更高算力的智能异构SoC芯片也在研发中	集成CPU、GPU、NPU以及eFPGA等核心IP,实现异构多核协同处理,形成高效处理标量、矢量和张量等多种计算的灵活高能效比计算平台	国内领先	机器人、无人机、车载等嵌入式计算平台等领域
5	微控制器芯片(MCU)	242.42	已形成低功耗、通用、高性能的低中高全系列产品体系,达到供货阶段,正在研制多核高性能计算系列微控制器	形成特种集成电路最完整谱系产品,高性能计算在微控制器领域应用落地	国内领先	电机控制、车载等嵌入式控制领域

序号	项目名称	2025年投入金额(万元)	进展或阶段性成果	拟达到目标	技术水平	具体应用前景
6	电源管理芯片	190.00	已形成快速瞬态响应、超低噪声 LDO 电压调整器和高功率密度高效率 DC-DC 转换器谱系化产品。面向高速转换器供电的 3A 以下超低噪声 LDO 电压调整器产品已经量产, 3A 以上大电流产品正在设计开发。高压 DC-DC 转换器 40V 以下已经量产, 60V-100V 及以上产品正在设计开发, 600V 高压驱动电源产品正在研发	面向高速通信和高速数据处理大电流 LDO 输出电流达到 5A, 高压 DC-DC 转换器耐压达到 100V, 大电流 DC-DC 转换器输出电流达到 100A, 高压大功率智能驱动控制器输入电压达到 600V	国内领先	高速通信、数据采集、伺服控制、精密测量、光伏、储能、数字能源等领域
7	总线接口芯片	160.47	已形成 245 总线、RS232/422/485 协议、LVDS 等接口谱系化产品; CAN 总线收发器、有源滤波器方向多款典型产品已经定型并小批量供货; 正在进行隔离 485 协议芯片研发	开发 35KV 高等级 ESD 结构、宽电源域输入端口、高数据率驱动器等设计, 形成功能全面、应用灵活的接口产品库	国内领先	信号传输、通信系统、计算机系统等领域
8	高精度数据转换 (ADC/DAC) 芯片	678.94	已完成一款 32 位隔离 ADC 和一款超低噪声并带有低漂移电压基准的单通道 ADC 研制, 正在进行更高采样率、更低噪声电压和集成可变增益放大器、可编程采样率和空间高可靠性设计等方面的产品扩展设计	集成高阶调制器、可编程增益放大器、高精度基准源等可复用核心电路, 形成精度高、采样率和输入范围可配置的通用 AD 转换器产品	国内领先	工业控制、陀螺、加速度计、热电偶、环境探测等领域
9	应用验证及其他	356.28	已形成飞控板、电机控制板、地检测试设备、近十款高可靠性信号处理 SiP 产品, 正在研制新一代高算力辅助信号处理 SiP 芯片。存储器芯片已成功研制 DDR3、DDR4、2GnorFlash, 达到供货阶段, 在研的 eMMC、NVRAM 已进入初样阶段	形成特种集成电路信号处理 SiP、系统板卡以及控制电路 SiP、系统板卡的核心供应商; 形成特殊集成电路通用存储器产品, 并辅助 SiP 类产品开发研制以及应用	国内一流	特种行业电子系统化、小型化, 高可靠性应用; 覆盖特种集成电路行业高算力系统应用中的存储器

2、深化市场导向战略，加速新客户拓展与老客户价值深耕双轮驱动

过去一年，公司紧密跟踪客户个性化需求与市场动态，通过快速调整研发策略提升响应效率，确保技术方案精准契合行业实际需求。2025 年度，公司与四川具身人形机器人科技有限公司、上海燧原科技有限公司分别达成战略合作：前者为围绕机器人“大脑”协同与“小脑”攻坚两大方向展开深度技术合作；后者为在大模型、高算力 GPU 领域展开深度合作。同步积极拓展潜在客户资源与合作机会。

在长期协作中建立的客户信任关系，为公司发展奠定坚实基础。为支撑新客户拓展与老客户深化合作，公司在济南、上海、西安、长沙设立研发中心及分支机构，持续追踪前沿技术与市场动向，强化市场与研发部门的协同效能。通过上述举措，公司深度挖掘客户需求，有效驱动新产品研发进程，进一步巩固特种集成电路设计领域的领先地位，为可持续发展提供核心动能。

二、加速推进募投项目实施，系统性提升科技创新实力

2024 年 2 月，公司在上海证券交易所科创板挂牌上市，募集资金总额约为人民币 15 亿元。截止 2025 年 12 月 31 日，公司募投项目累计投入 83,056.88 万元（未包含补充流动资金项目部分），针对“芯片研发及产业化”项目，公司 2025 年共投入 23,144.63 万元，总投资进度为 50.11%，未来公司将继续就高性能 FPGA、高速高精度 ADC、自适应智能 SoC 等三个方向的产品研发进行持续投入，尽早完成产品研发并实现产业化。在“高端集成电路研发及产业基地”项目上，公司 2025 年共投入 9,432.27 万元，总投资进度 82.68%，目前已基本建成检测中心和研发中心并初步投入使用，该项目的实施将助力公司打造集设计、测试、应用开发为一体的高端集成电路产业平台，强化巩固公司在特种集成电路领域的核心地位。

未来，公司将系统推进募投项目全生命周期管理，构建“规划-实施-监控-优化”的闭环管理体系。在项目执行层面，严格遵循募集资金的管理要求，谨慎合理地使用资金，确保募投项目按照既定规划稳步开展。通过募投项目的落地，公司旨在：一是促进主营业务持续发展；二是实现项目预期效益；三是最终提升整体盈利水平；四是全方位强化核心竞争力、盈利能力及产品市场影响力。

三、治理聚焦核心体系，系统化构建履职能力

2025年，公司根据新《公司法》及证监会、交易所最新监管要求，对《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行了全面适应性修订，核心调整包括优化组织机构设置、取消监事会（监事）并明确审计委员会对应职权，以及增设职工代表董事席位；修订《独立董事工作制度》，为独立董事履职信息支撑提供制度依据，在独立董事专门委员会机制中引入重大事项事前讨论功能；进一步优化 ESG 治理架构，优化《战略与 ESG 委员会工作细则》明确 ESG 相关职权，并发布了第 1 份 ESG 报告。切实加强公司控股股东、实际控制人、董高人员作为“关键少数”的责任意识和规范意识。积极组织董高参加上市公司协会、上海证券交易所举办的董事、高管培训课程。公司以“合规为基、创新为翼”，搭建权责清晰、全员参与的内控体系，在确保满足内部控制要求的同时，注重管理创新，明确相关部门人员的职责和权限，强化员工自律合规意识，形成约束与协同并重的治理机制。

展望 2026 年，公司将根据新《公司法》等相关法律法规，进一步对公司治理结构以及《公司章程》等相关治理制度进行修改和完善，具体措施如下：

1、内部治理制度的持续优化

2026 年，公司将持续跟踪新《公司法》配套规则及《上市公司章程指引》的修订进展，动态优化股东会、董事会及审计委员会等治理架构，及时更新内部管理制度，确保治理体系与最新法规要求同步，切实维护投资者合法权益。

2、强化“关键少数”履职能力建设

公司将常态化组织董高参加上市公司协会、交易所等机构的专项培训，确保其及时掌握法规变化，提升履职能力。同时建立监管信息快速传导机制，确保董事会及管理层与监管政策保持同步。

3、优化独立董事履职生态

完善独立董事信息支持机制，及时通报经营动态及重大事项，充分保障其知情权与监督权，切实发挥独立董事在重大事项事前讨论中的专业把关作用。

4、深化 ESG 管理实践

在现有 ESG 治理架构基础上，公司将进一步优化环境、社会及治理绩效，

加大创新研发投入，践行以人为本与绿色发展理念，强化与利益相关方的沟通互动，持续提升 ESG 管理水平，推动可持续发展目标实现。

四、持续强化与投资者的沟通交流，增强信息披露的透明度

公司始终将投资者关系管理置于战略高度，坚定不移地贯彻“以投资者为核心”的服务理念，通过构建多元化沟通渠道，主动与投资者开展深度交流，确保公司信息传递的及时性、准确性与完整性。公司高度重视投资者声音，认真倾听并积极采纳相关意见和建议，致力于为投资者提供全面、专业、优质的服务体验，为打造长期稳定、互信共赢的投资者关系筑牢坚实根基。

在日常工作中，公司积极接听投资者专线电话，通过 IR 邮箱及时回复各类投资咨询，并充分借助“上证 e 互动”等线上平台与投资者保持高频互动。在定期报告披露后，公司会在“上证路演中心”“全景网”等专业平台举办投资者交流会，深入剖析公司经营业绩，对定期报告进行全面详细解读，助力投资者更清晰、更深入地了解公司的财务状况、业务发展态势及未来战略规划。

2025 年，公司在上证路演中心共举办了 3 次业绩说明会，并通过自愿披露公告、公司官方公众号平台等方式，以便投资者能够第一时间获取公司的最新动态与重要信息。在信息披露方面，公司严格遵循《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，建立健全信息披露管理制度，确保所有可能对公司股票交易价格产生重大影响的信息均能做到真实、准确、完整、及时披露，切实保障公司信息披露的透明度与公信力。

展望 2026 年，公司将继续严格遵守法律法规，持续优化投资者关系管理体系，不断提升管理专业化水平，以实现公司长期价值与股东利益的最大化为根本目标。具体措施包括：持续完善投资者管理工作机制，进一步拓展与投资者的交流渠道，丰富互动形式；继续依托“上证路演中心”等专业平台，计划举办不少于 3 次投资者线上交流会；同时，公司将深度利用官方网站以及公司官方公众号平台，为投资者提供多种便捷、高效、及时的信息获取渠道，确保投资者能够全方位、多角度地了解公司发展动态，持续提升投资者关系管理的质量与效能。

五、回报聚焦股东价值，系统化构建市场信心

公司始终将投资者回报置于战略高度，坚持在符合分红条件的前提下，综合

考虑实际经营状况与未来发展需求，科学制定利润分配政策，通过积极实施现金分红，让投资者切实分享公司发展成果。为贯彻落实《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》，公司在充分关注自身投资价值的基础上，进一步提升投资者回报水平。

结合当前整体经营状况及发展阶段，经董事会决议，公司 2025 年度拟以派发现金红利的方式进行利润分配，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.49 元（含税），以总股本 636,847,026 股计算，合计拟派发现金分红 31,205,504.27 元（含税）。综合本年度现金分红方案来看，自上市以来公司已累计现金分红 115,269,311.70 元（含税）。

2026 年，公司将在年度股东会审议通过 2025 年利润分配方案后，推进 2025 年度利润分配方案落地实施。展望未来，公司将结合经营发展需求与业务战略目标，深入研究中期分红、多次分红的可行性，合理提升分红率和股息率，构建“持续、稳定、科学”的股东回报机制，秉持“投资者为本”的发展理念，切实维护广大股东合法权益，确保公司长期稳健发展，努力为投资者创造更丰厚回报，实现公司与投资者的互利共赢。

六、绑定管理层团队，机制化构建股东共享格局

当前正值公司高质量发展的关键阶段，公司高度重视高管激励约束机制建设，建立了与经营绩效紧密挂钩的薪酬体系，由固定薪资、年终绩效奖金及专项奖金三部分构成。公司每年制定经营目标责任书，并依据上一年度经营成果、盈利能力等核心指标，结合高管及其分管业务的 KPI 完成情况，综合评定激励薪酬。KPI 体系全面覆盖销售业绩、订单规模、利润率、客户拓展、生产规划、产品质量、研发进展、安全管理等维度，高管个人绩效则综合工作表现与目标达成度评定。

2026 年，公司将持续优化并严格执行高管薪酬方案，确保薪酬结构与经营表现深度绑定；同时通过完善管理层与股东利益共担共享机制、探索长效激励等举措，强化高管责任意识，实现利益绑定，推动公司稳健发展。

七、行动聚焦持续优化，系统化构建市场形象

公司将持续跟踪评估“提质增效重回报”行动方案落实情况，并按时履行信

息披露义务。聚焦核心业务，增强核心竞争力、盈利能力及风险管理能力；通过优化经营管理、规范公司治理、积极回馈投资者，切实维护投资者利益，履行上市公司责任，回报投资者信任，保持良好市场形象，推动资本市场平稳健康发展。

本次行动方案系根据公司当前实际情况制定的，并非对投资者的实质性承诺。未来，该方案可能会受到宏观政策调整、行业环境变化等因素的影响，存在一定不确定性，敬请广大投资者关注相关风险。

成都华微电子科技股份有限公司

董事会

2026年4月29日